

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2016-044

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,742,443,305.38	1,110,155,104.23	56.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,488,306.67	84,125,221.20	1.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,605,791.89	36,490,527.39	-5.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	672,435,612.70	97,256,130.60	591.41%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.98%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,443,727,181.34	6,511,942,944.85	60.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,799,703,183.48	3,740,388,672.42	1.59%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	71,052				
前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售	质押或冻结情况

				条件的普通 股数量	股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.25%	303,967,802	0	质押	86,840,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	207,991,680	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.31%	12,780,338	0		
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	其他	1.11%	10,835,596	0		
财富证券—浦发银行—财富证券星城 6 号集合资产管理计划	其他	1.03%	10,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.93%	8,999,888	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.75%	7,300,493	0		
华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司	其他	0.49%	4,743,682	0		
财通基金—上海银行—易方达资产管理有限公司	其他	0.47%	4,600,921	0		
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 185 号资产管理计划	其他	0.38%	3,681,336	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：第 1 和第 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)概述

根据WSTS统计，2016年上半年全球半导体市场销售额1,574亿美元，同比下降了5.8%。2016年上半年中国集成电路产业受到全球半导体市场下滑影响，增幅比第一季度略有下降，上半年中国集成电路产业销售额同比增长16.1%，比第一季度增幅下降了0.4个百分点，销售额为1847.1亿元。其中，设计业销售额为685.5亿元，同比增长24.6%；制造业销售额454.8亿元，同比增长14.8%；封装测试业销售额706.8亿元，同比增长9.5%。（出处：中国半导体行业协会）

当前，公司正处于产业发展千载难逢的大发展机遇期。在产业政策的引导下，2016、2017年新建的晶圆厂至少有19座，其中有10座建于中国，总投资达千亿级别。7月31日，中国高端芯片联盟正式成立，该联盟的宗旨是围绕高端芯片领域，以建立产业生态为目标，以重点骨干企业为主体，整合各方资源，建立产、学、研，用深度融合的联盟，推动协调创新，促进核心技术和产品应用推广，探索体制机制创新，打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系。在中国高端芯

片联盟成立和半导体产业链建设的推动下，芯片、存储、处理器等集成电路细分产业，也将迎来快速发展机遇。

2016年上半年，公司围绕2016年经营目标以及“理顺集团架构，明晰职权关系，兼顾集团控制力与下属企业主观能动性，确保南通通富工厂、合肥通富工厂早日投入使用，确保苏州、槟城工厂顺利交割、平稳运行”的公司集团化发展总体要求，公司上下团结一心，积极适应经济发展新常态，在市场开拓、技术进步与科技创新、并购重组、基地建设、人才建设、智能制造等方面均取得了良好成绩，形成了新的增长动力，保证了公司经营效益的持续稳定增长。

(1) 抢抓市场机遇，开拓市场，公司主营业务收入稳定增长

上半年，公司整体实现营业收入174,244.33万元，同比增长56.95%；其中，崇川工厂实现营业收入127,756.72万元，6月份单月销售25,375.25万元，创月销售额新高。苏州、槟城工厂股权交割后，5、6月份共计实现营业收入45,695.89万元，实现盈利4,336.22万元，较好地完成了二季度生产计划。

上半年，公司在继续扩大与重点客户的战略合作的同时，积极开拓新客户业务，BGA、QFN、WLP等先进封装产品稳定增长，BGA产品销售额同比增长43.4%，QFN产品、WLP产品销售额同比分别增长41.62%、75.25%；新品开发方面，继续扩大与欧美重点客户的战略合作，成功启动包括超宽多排SOT、TO220FP消费类产品等多个重点客户的新品项目；亚太市场方面，PA产品、指纹识别产品等实现量产；2016年上半年，公司获TI客户颁发的“2015年度20亿块出货量里程碑”奖杯，这是继“最具成长供应商奖”后公司获得的又一殊荣。

(2) 突出市场导向作用，加快技术创新及创新成果的研发与转化

1、完成了具有自主知识产权的FOWLP工艺流程、光学传感器封装技术研发，以及vision intape等多项新测试解决方案；公司“12英寸28纳米晶圆级先进封装测试制程技术”入选第十届中国半导体创新技术产品，公司产品技术竞争力进一步提升。

2、02项目实施进展顺利，5月27日，公司牵头承担的“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目通过国家专项办的正式验收。上半年，公司获各级政府科技、技改等专项资金2,632.31万元。

3、截至报告期末，公司已累计申请专利594件，累计授权专利284件；2016年上半年，新增专利授权64件：其中中国发明专利33件、实用新型专利21件、美国发明专利10件。

(3) 做大产业规模，加快基地布局与建设，促进集团化、规模化发展

1、报告期内，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权的交割工作，此项目从启动到完成交割历时16个月，在国家集成电路产业投资基金股份有限公司的大力扶持下，完成了一系列复杂的并购谈判工作，履行了交割所需的各项政府手续。通过与AMD合作、合资，使得公司在倒装芯片（FC）封装领域的技术达到世界一流水平，显著提升了公司在高端封装领域的服务能力和竞争力；合并报表后，公司在全球封装行业的排名将有望进入世界前六位。

股权交割后，公司将“维护苏州、槟城人员稳定”放在首要位置，采取了切实有效的措施，确保了苏州工厂、槟城工厂高级管理人员以及核心技术人员的稳定，确保了两家工厂交割后的平稳过渡，5、6月份，两家合资公司运营稳健，较好地完成了2季度的运营计划。

报告期内，通富超威苏州、通富超威槟城的AMD产品稳定增长，按计划完成新产品、新技术的导入工作，APU、GPU、游戏机等新产品通过认证、成功实现量产；成功实现14nm工艺产品，并准备导入AMD新一代处理器基础模块。2016年上半年，AMD的经营情况较去年明显改善，2016年第二季度实现营业收入10.27亿美元，环比增加23%，同比增加9%，主要归功于半定制SoC产品销量增加。AMD Polaris新的14nm GPU结构和RX 480显卡继续表现出良好的需求、X86 IP专利买卖谈判比预期快得多，再加上AMD利用半定制产品的强大实力以及面向最新Radeon RX GPU和第七代A系列APU的大量需求，这些为AMD今年下半年推动增长、开拓市场份额奠定了良好基础。预计，AMD在2016年第三季度的营业额将环比增长18%，上下浮动3个百分点。AMD整体发展状况喜人，为通富超威苏州、通富超威槟城的订单提供了保障。

此外，公司积极引导和帮助两家工厂开拓新客户，目前多家国内外知名大厂正在进行样品生产、考核；槟城工厂成功导入AMD以外的欧美客户，积极开展扩产计划；国内一流的集成电路设计公司，已启动在苏州工厂的小批量生产。同时，公司配合其寻找并建立与当地供应商的战略合作，为尽快适应并建立有竞争力的OSAT运营模式奠定了良好基础。

2、加快南通通富工厂、合肥通富工厂两个基地的建设工作。5月30日，两个生产基地分别举行新工厂首台设备进场仪式。目前两个工厂都按照计划进行产品考核与初期量产，计划年内实现量产。

(4) 员工队伍不断扩大、人才引进步伐加快

上半年，公司共引进高端人才30名，招募本科及以上学历以上大学生232人。员工队伍的不断扩大，为实现公司集团化发展，规模化生产，加快技术创新与成果产业化应用提供了保障，公司基本形成了具有国际化视野的一流的技术管理团队。

(5) 加快智能工厂建设，推进“工业化及信息化”深度融合

围绕“智能化工厂”建设目标，上半年继续开展了WLP、组装、FT测试、CP等多个生产自动化项目，以实现设备相关自动化功能；启动了苏通、合肥工厂智能化系统建设，苏通、合肥工厂数据中心方案、集团数据中心方案、集团网络建设方案等项目正按照计划进行中；启动苏州、槟城工厂SAP导入项目，计划在年底前完成财报数据从AMD系统切换至公司总部。通过开展上述项目，公司将拥有智能化生产控制中心，实现智能化生产执行过程，更好地实现公司总部与各工厂之间的数据无缝衔接，提高决策及管理效率，通过系统实现融合。

(二) 主营业务分析

概述

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，公司总体经营情况良好，客户、产品结构不断优化；4月29日，公司完

成AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，公司生产规模进一步扩大。报告期内，公司实现营业收入174,244.33万元，同比增长56.95%；利润总额11,826.39万元，同比增长26.71%；公司净利润11,065.28万元，同比增长31.53%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,742,443,305.38	1,110,155,104.23	56.95%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并了其营业收入以及原有营业收入比去年增长16%所致。
营业成本	1,422,737,377.88	859,454,215.71	65.54%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并了其营业成本以及原有营业成本的增长所致。
销售费用	11,246,305.35	6,473,553.85	73.73%	公司加大市场开拓力度所致。
管理费用	239,934,471.00	180,187,376.36	33.16%	主要系合并了AMD苏州以及AMD槟城的管理费用，以及收购发生的中介费用等。
财务费用	24,351,379.06	16,775,053.16	45.16%	公司扩大规模，增加银行借款所致。
所得税费用	7,611,021.62	9,211,176.22	-17.37%	不适用
研发投入	133,034,701.28	114,238,739.84	16.45%	不适用
经营活动产生的现金流量净额	672,435,612.70	97,256,130.60	591.41%	主要系合并了AMD苏州以及AMD槟城的经营活动现金流，及原有业务经营活动现金净流量的增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,037,571,789.72	-1,377,847,312.23	120.46%	主要系报告期内公司并购AMD苏州及AMD槟城支付的并购款造成投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,180,143,956.57	1,565,488,320.75	103.14%	主要系报告期内公司为并购AMD苏州及AMD槟城而筹集的并购资金所致。
现金及现金等价物净增加额	792,508,293.20	287,793,527.85	175.37%	主要系公司经营规模的扩张所致
货币资金	2,410,359,922.15	1,437,970,103.61	67.62%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。
应收票据	40,870,289.42	27,107,556.21	50.77%	
应收账款	908,311,546.41	492,286,701.48	84.51%	
预付款项	14,986,882.39	10,413,943.60	43.91%	
存货	647,101,725.25	317,591,417.02	103.75%	
其他流动资产	141,619,452.48	650,897,302.69	-78.24%	主要系报告期募集资金使用，利用募集资金委托银行理财资金减少所致。
固定资产	3,907,255,799.94	2,714,807,148.27	43.92%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加，以及南通通富、合肥通富投资建设所致。
在建工程	907,080,178.90	611,392,431.15	48.36%	
无形资产	261,189,887.00	124,790,095.22	109.30%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。
递延所得税资产	74,927,401.19	9,828,035.84	662.38%	
总资产	10,443,727,181.34	6,511,942,944.85	60.38%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加，以及南通通富、合肥通富投资建设所致。
应付账款	1,045,717,077.10	501,826,169.29	108.38%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。
应付职工薪酬	31,055,652.03	17,479,749.63	77.67%	
应交税费	15,357,126.69	6,650,321.05	130.92%	
应付利息	12,579,477.09	3,272,843.24	284.36%	主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基金、合

				肥城建代本公司垫付合肥通富股权收购投资款利息，以及计提国开基金代本公司垫付南通通富股权收购投资款利息增加所致。
其他应付款	44,076,997.07	7,468,159.60	490.20%	主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。
一年内到期的非流动负债	294,758,574.98	159,740,400.00	84.52%	主要系公司规模扩大，银行借款增加所致。
其他非流动负债	1,008,000,000.00	552,000,000.00	82.61%	主要系合肥海恒集团、合肥产业基金、合肥城建代本公司垫付合肥通富股权收购投资款增加所致。

(三) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路封装测试	1,737,186,449.18	1,421,748,254.61	18.16%	57.38%	65.43%	-3.98%
分产品						
集成电路封装测试	1,737,186,449.18	1,421,748,254.61	18.16%	57.38%	65.43%	-3.98%
分地区						
中国境内	347,801,266.84	300,452,243.71	13.61%	26.98%	33.01%	-3.91%
中国境外	1,389,385,182.34	1,121,296,010.90	19.30%	67.41%	76.99%	-4.37%

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权的交割工作，通过与AMD合作、合资，使得公司在倒装芯片（FC）封测领域的技术达到世界一流水平，显著提升了公司在高端封测领域的服务能力和竞争力，带动公司高端产品及客户结构的优化，进一步提升公司的盈利能力；合并报表后，公司在全球封测行业的排名将有望进入世界前六位，跻身世界一流封测公司的行列。

除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化，具体详见公司《2015年年度报告》核心竞争力分析章节。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年新设立的富润达、通润达、钜天投资以及非同一控制下企业合并取得的通富超威苏州、通富超威槟城。上述公司自设立起纳入本公司合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2016 年 08 月 25 日